

ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業  
 研究開発項目②先端半導体製造技術の開発  
 採択結果一覧

No.	開発テーマ	実施体制(予定)
1	(b1)高性能コンピューティング向け実装技術	<p><b>TSMCジャパン3DIC研究開発センター株式会社</b></p> <p>(共同実施先、協力企業等)            国立研究開発法人産業技術総合研究所、イビデン株式会社、多数の国内材料、製造装置メーカー、大学・研究機関(※企業・機関名は採択テーマ概要資料を参照)</p>
2	(b2)エッジコンピューティング向け実装技術	<p><b>先端システム技術研究組合</b></p> <p>(共同実施先、組合員企業等)            国立研究開発法人産業技術総合研究所、株式会社SCREENホールディングス、ダイキン工業株式会社、富士フイルム株式会社、パナソニックスマートファクトリソリューションズ株式会社、国立大学法人東京大学</p>
3		<p><b>ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社</b></p>
4	(b3)実装共通基盤技術	<p><b>昭和電工マテリアルズ株式会社</b></p> <p>(共同実施先、協力企業等)            味の素ファインテクノ株式会社、上村工業株式会社、株式会社荏原製作所、株式会社新川、新光電気工業株式会社、大日本印刷株式会社、株式会社ディスコ、東京応化工業株式会社、TOWA株式会社、ナミックス株式会社、パナソニックスマートファクトリソリューションズ株式会社、ヤマハロボティクスホールディングス株式会社</p>
5		<p><b>住友ベークライト株式会社</b></p>